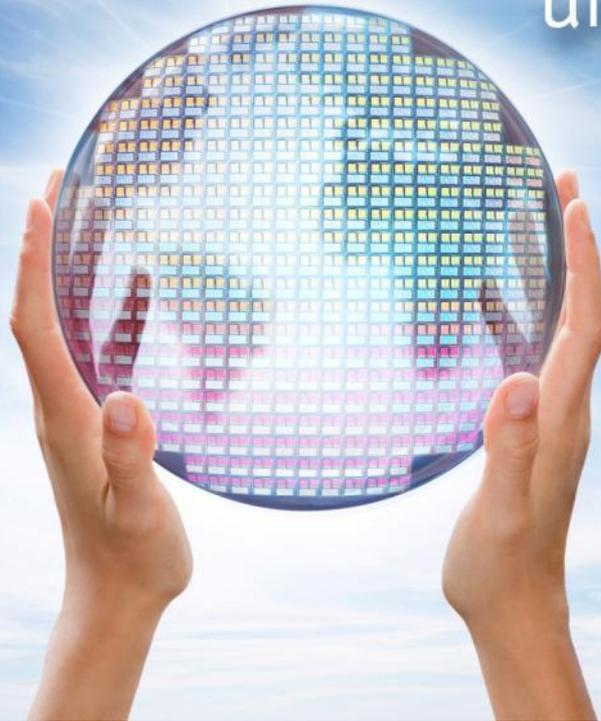


Innovative Halbleiter-Lösungen für mehr **Energieeffizienz, Mobilität** und **Sicherheit**



Unternehmenspräsentation

01. Februar 2012



- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2012
- Zielmärkte
- Divisionen, Produkte und Technologien
- Allgemeine Informationen zum Unternehmen

- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2012

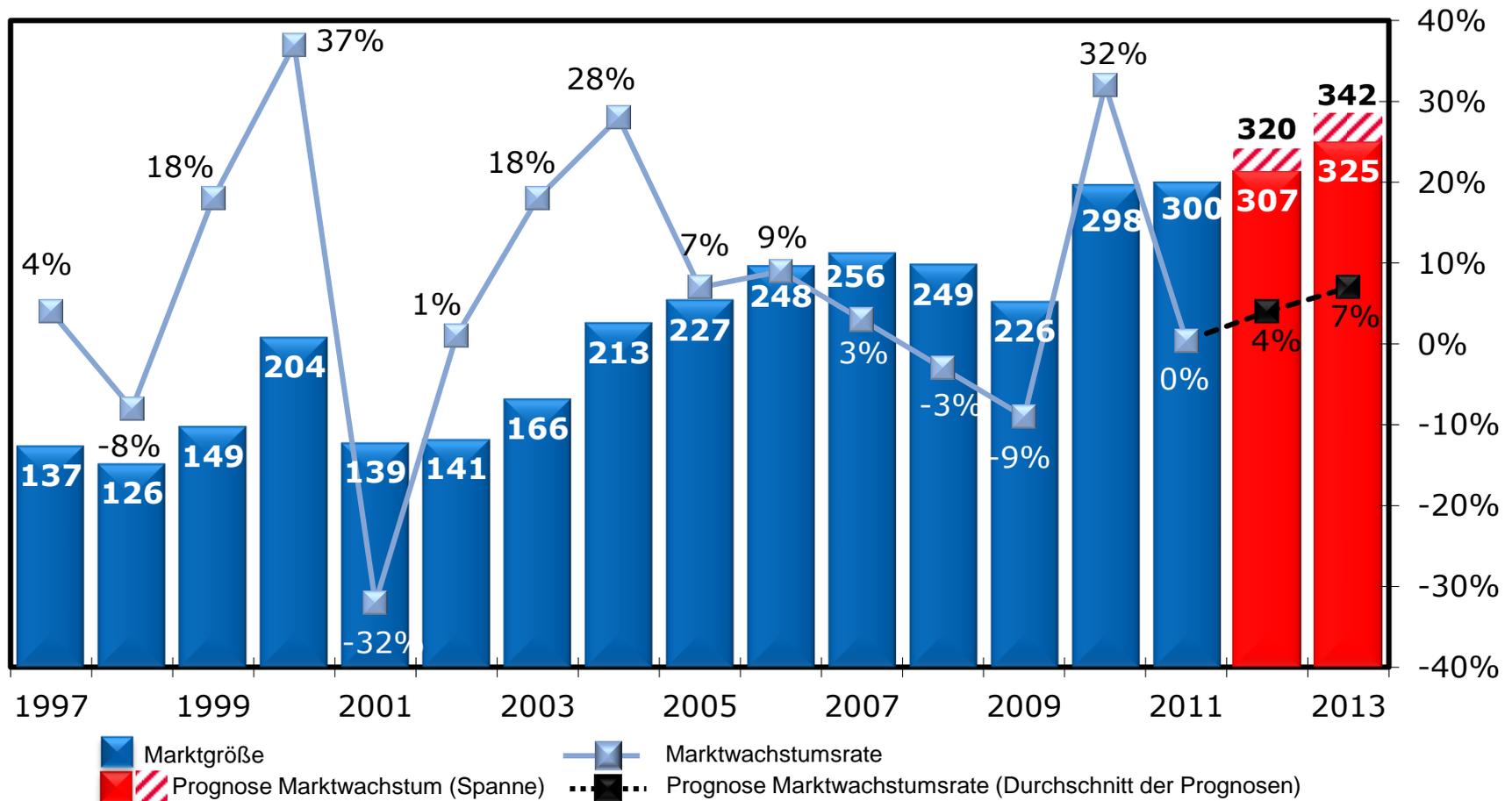
- Zielmärkte

- Divisionen, Produkte und Technologien

- Allgemeine Informationen zum Unternehmen

Entwicklung des globalen Halbleitermarkts

Marktgröße in Milliarden US-Dollar und Marktwachstumsrate

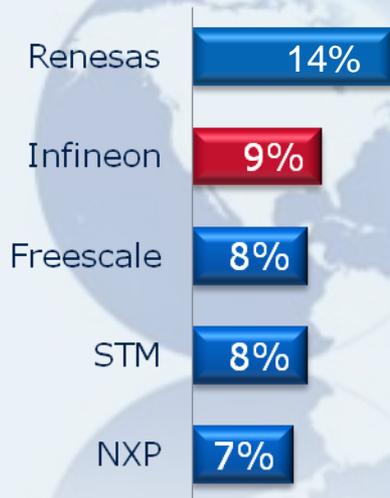


Quelle: WSTS für historische Daten; Prognose: Ø von IHS iSuppli, IC Insights, VLSI, WSTS; Marktwachstumsrate im Jahresvergleich; Stand 31. Januar 2012

Führende Position in allen Zielmärkten

Automobilelektronik

#2



Kalenderjahr 2010.
Quelle: Strategy Analytics, April 2011

Leistungshalbleiter

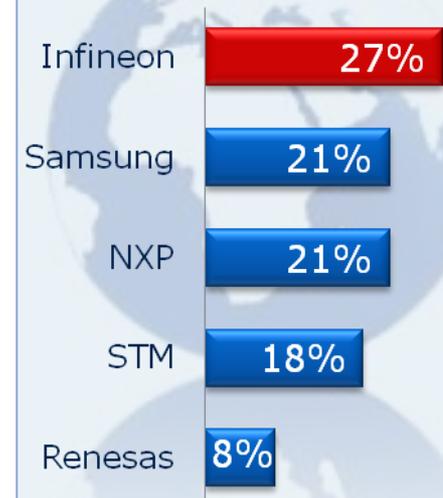
#1



Kalenderjahr 2010.
Quelle: IMS Research, August 2011

Chipkarten

#1



Kalenderjahr 2010.
Quelle: IMS Research, August 2011.

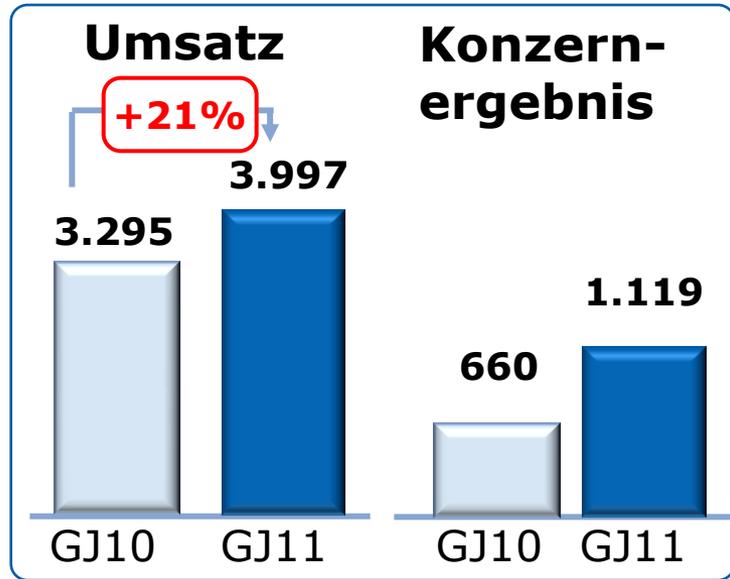
Das Unternehmen

- Infineon adressiert mit seinen Halbleiter- und Systemlösungen die zentralen Bedürfnisse der modernen Gesellschaft: **Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit**
- Umsatz im Geschäftsjahr 2011*: 3,997 Mrd. EUR
- 26.026 Mitarbeiter weltweit (Stand: Januar 2012)
- Starkes Technologieportfolio mit ca. **15.700** Patenten und Patentanmeldungen (Stand: September 2011)
- **Über 20 F&E-Standorte**
- Deutschlands größtes und Europas zweitgrößtes Halbleiterunternehmen

*Hinweis: Angaben gemäß IFRS einschließlich der Wireline- und Wireless-Sparten als nicht fortgeführte Aktivitäten;
Stand: 30. September 2010

Infineon-Konzern

Ergebnisse GJ 2010 und GJ 2011



[Mio. Euro]	2010	2011
-------------	------	------

Umsatz	3.295	3.997
--------	-------	-------



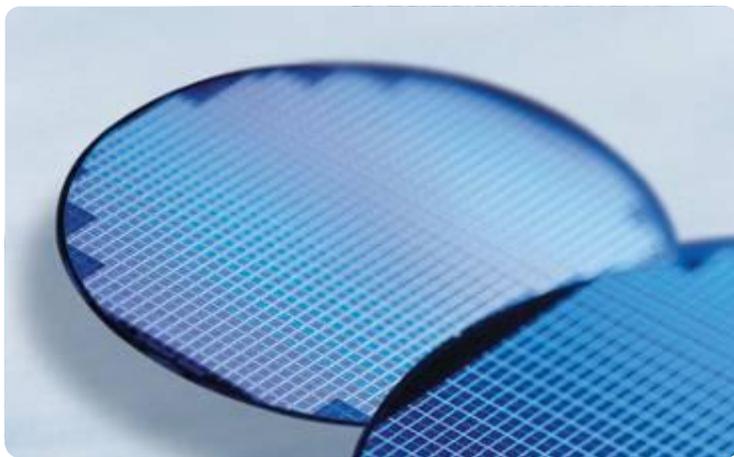
Segmentergebnis	475	786
-----------------	-----	-----



Segmenterg. Marge	14,4%	19,7%
-------------------	-------	-------



Konzernergebnis	660	1.119
-----------------	-----	-------



Free-Cash-Flow	573	106
----------------	-----	-----



Investitionen (Sachanl.)	292	845
--------------------------	-----	-----



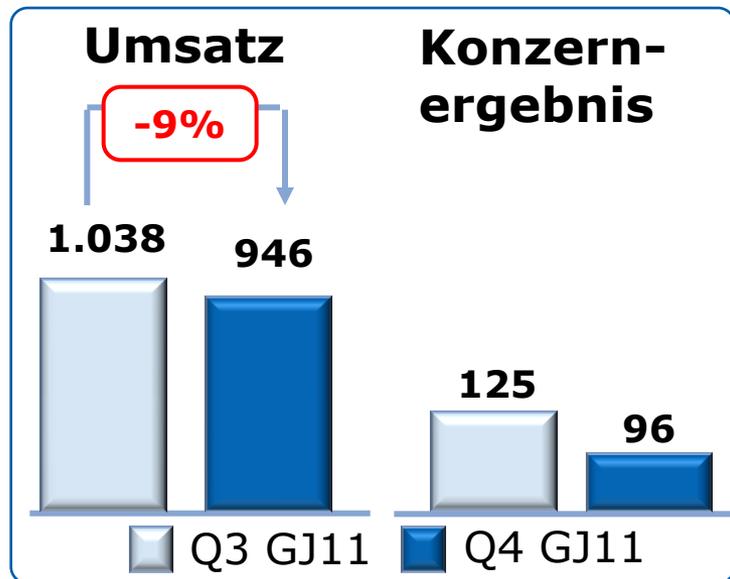
Netto-Cash	1.331	2.387
------------	-------	-------



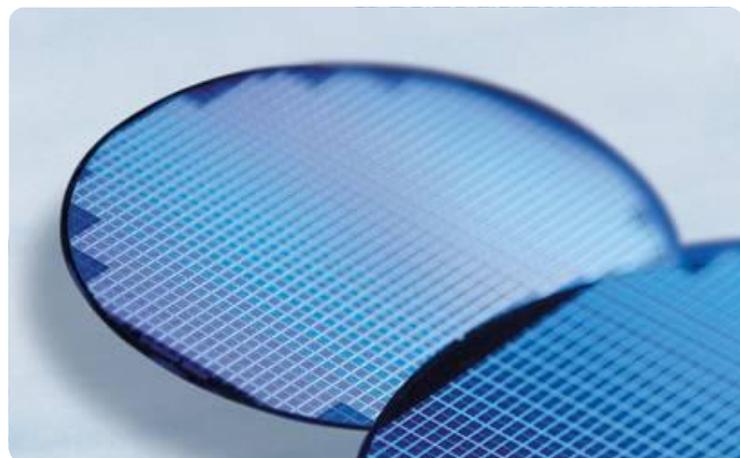
Marktkapitalisierung	~5.522	~6.073
----------------------	--------	--------



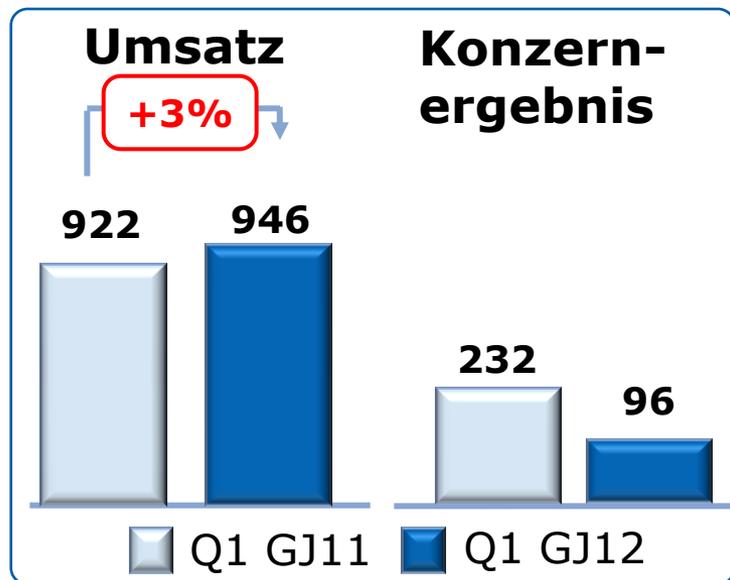
Hinweis: Angaben gemäß IFRS einschließlich Wireline und Wireless als nicht fortgeführte Aktivitäten



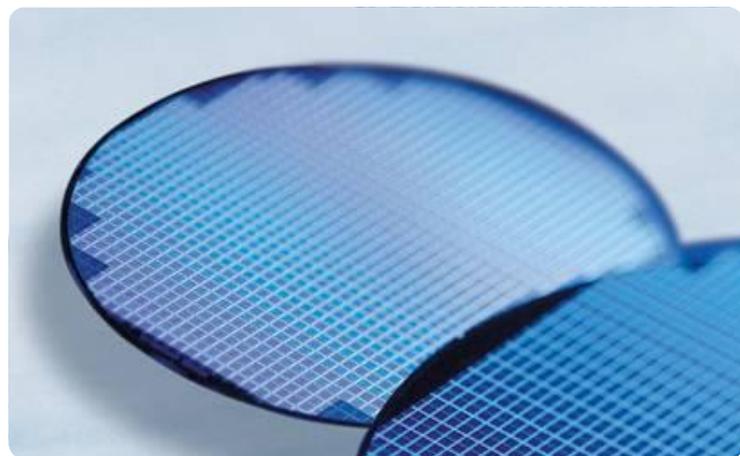
[Mio. Euro]	Q4 11	Q1 12
Umsatz	1.038	946
Segmentergebnis	195	141
Segmenterg. Marge	19%	15%
Konzernergebnis	125	96
Free-Cash-Flow	97	-234
Brutto-Cash-Position	2.692	2.337
Netto-Cash-Position	2.387	2.068



Hinweis: Angaben gemäß IFRS einschließlich Wireline und Wireless als nicht fortgeführte Aktivitäten



[Mio. Euro]	Q1 11	Q1 12	
Umsatz	922	946	
Segmentergebnis	177	141	
Segmenterg. Marge	19%	15%	
Konzernergebnis	232	125	
Free-Cash -Flow	4	-234	
Brutto-Cash-Position	1.669	2.337	
Netto-Cash-Position	1.293	2.068	



Hinweis: Angaben gemäß IFRS einschließlich Wireline und Wireless als nicht fortgeführte Aktivitäten

Umsatzerlöse nach Segmenten Q4 GJ 2011 und Q1 GJ 2012

Umsatz* in Mio. Euro

Anteil am Gesamtumsatz

ATV



Q4 GJ'11



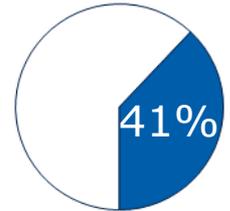
396

Q1 GJ'12



391

-1%



IMM



Q4 GJ'11



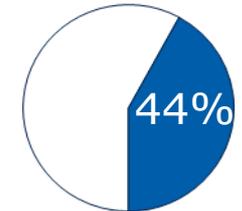
472

Q1 GJ'12



418

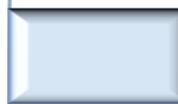
-11%



CCS



Q4 GJ'11



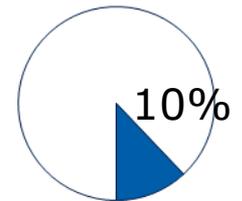
116

Q1 GJ'12



97

-16%



* Im Gesamtumsatz (Q4 GJ11: 1.038 Mio. €; Q1 GJ12: 946 Mio. €) enthalten sind Sonstige Geschäftsbereiche (Q4 GJ11: 60 Mio. €, Q1 GJ12: 43 Mio. €) sowie Konzernfunktionen und Eliminierungen (Q4 GJ11: -6 Mio. €, Q1 GJ12: -3 Mio. €).

Ergebnisse nach Segmenten Q4 GJ 2011 und Q1 GJ 2012

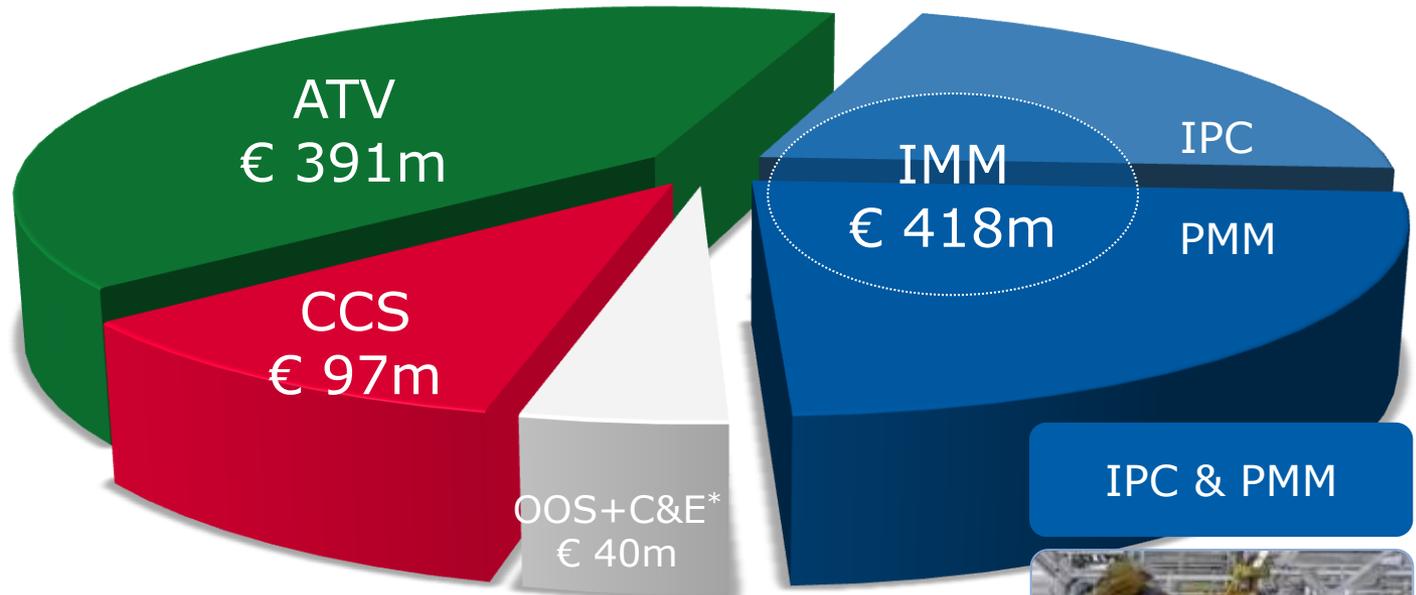
Segmentergebnis* in Mio. Euro				Marge	
ATV		Q4 GJ 2011		66	17%
		Q1 GJ 2012		55	14%
IMM		Q4 GJ 2011		113	24%
		Q1 GJ 2012		79	19%
CCS		Q4 GJ 2011		16	14%
		Q1 GJ 2012		6	6%

*Im Gesamtsegmentergebnis (Q4 GJ11: 195 Mio. €; Q1 GJ12: 141 Mio. €) enthalten sind Sonstige Geschäftsbereiche (Q4 GJ11: 2 Mio. €, Q1 GJ12: 4 Mio. €) sowie Konzernfunktionen und Eliminierungen (Q4 GJ11: -2 Mio. €, Q1 GJ12: -3 Mio. €).

Umsatz nach Divisionen

Umsatz in Geschäftsjahr 2011: EUR 946m

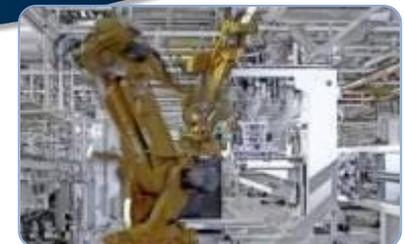
Automotive



Chip Card & Security



IPC & PMM



* Other Operating Segments;
Corporate & Eliminations.

Umsatz nach Regionen GJ 2010 and GJ 2011 *)

*) ab GJ 2011 Änderung in der Regionenstruktur

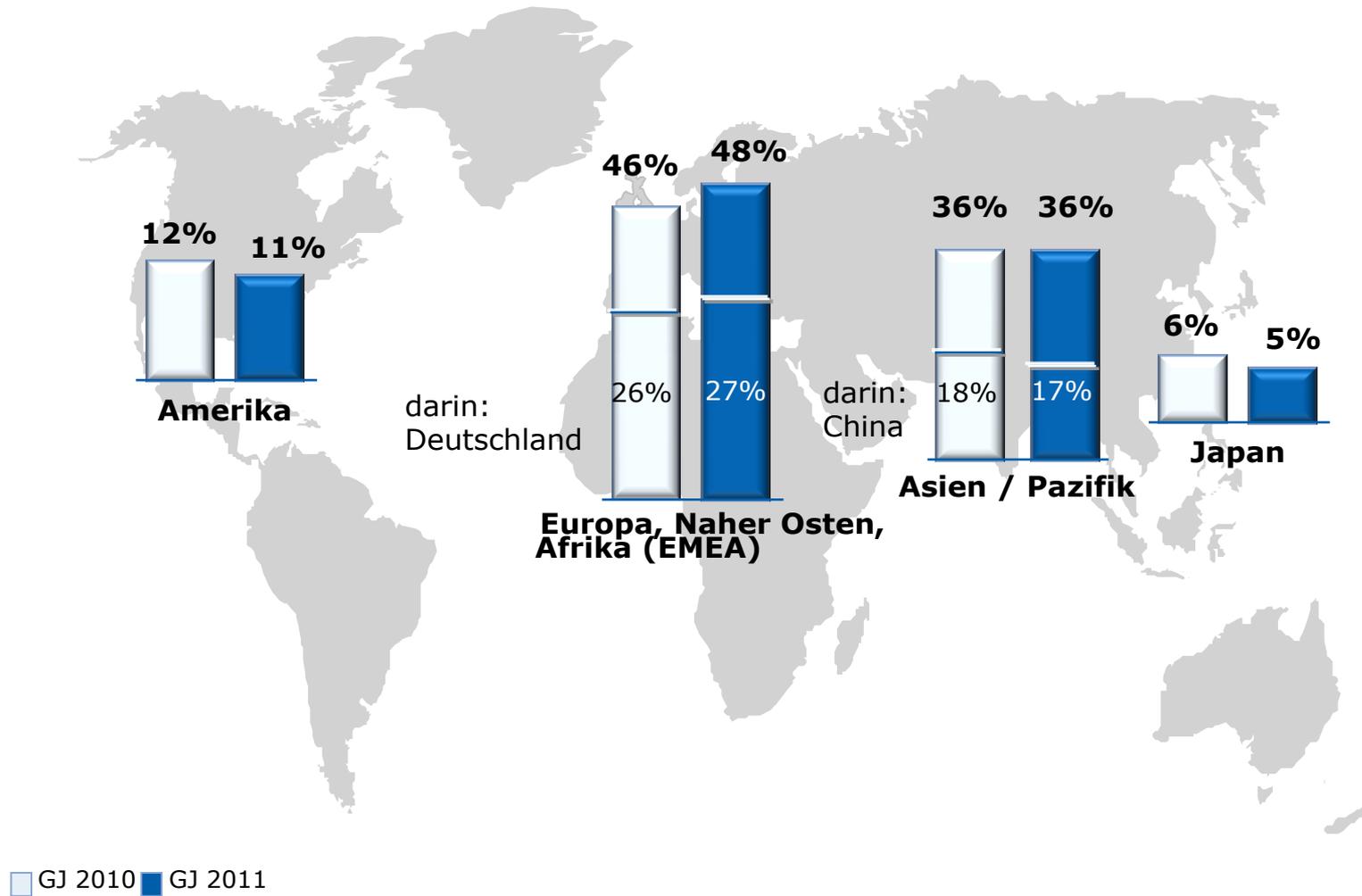


Table of Contents

■ Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2012

■ **Zielfmärkte**

■ Divisionen, Produkte und Technologien

■ Allgemeine Informationen zum Unternehmen

Infineon Compass - Kurzfassung

Unsere Bestimmung

Wir sind der Innovationsführer bei Halbleitern für Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Unsere Lösungen unterstützen moderne Gesellschaften zu wachsen und schützen zugleich die Umwelt.

Unser Weg

Unsere Mitarbeiter sind die Basis der einzigartigen Wettbewerbsvorteile, guter finanzieller Ergebnisse und Höchstleistungen von Infineon. Wir wollen unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären das Beste bieten – zu jeder Zeit, an jedem Ort.

Unsere Werte

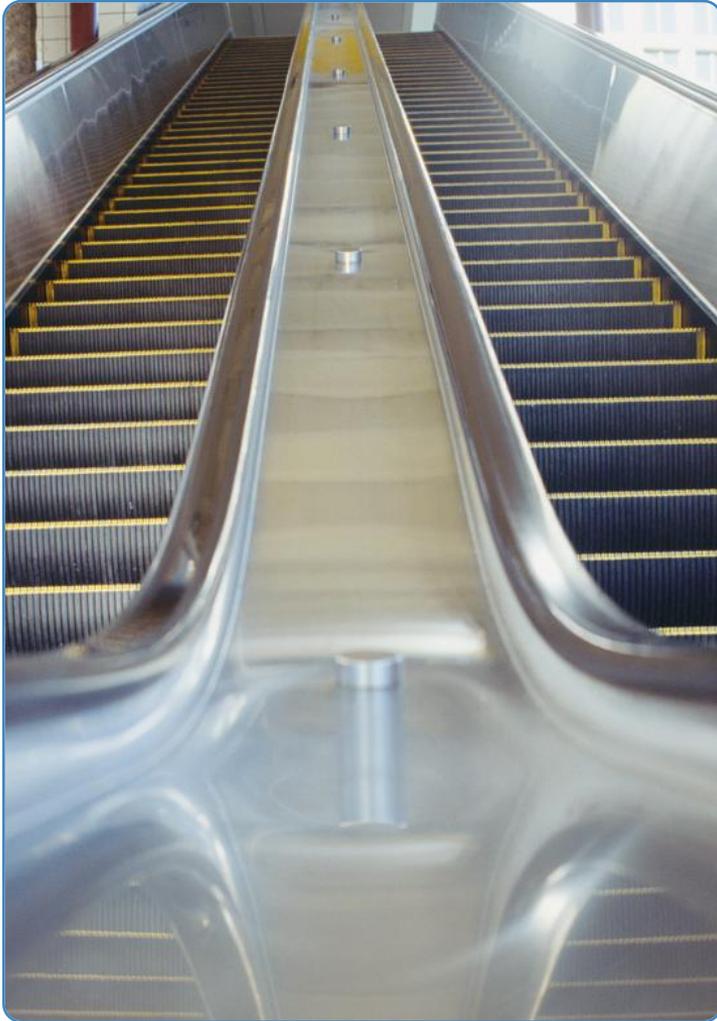
Vier Grundwerte sind der Antrieb in unserer täglichen Arbeit:

We commit (Wir handeln engagiert und verbindlich) – We innovate (Wir sind innovativ) – We partner (Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen) – We perform (Wir bringen Leistung).



Photos: helgahengge.com

Auf dem Weg zu einem High-Performance-Unternehmen



- Erfolgreiche Umstrukturierung dank IFX10+
 - Konsequente Kostenreduzierung
 - Effizienzsteigerung
- Erfolgreiche Refinanzierung 2009
 - Rückkauf und Tilgung nachrangiger Umtausch- und Wandelanleihen 2009 (Gesamt: 367 Mio. Euro nominal)
 - Ausgabe einer neuen nachrangigen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2014, Bruttoertrag ca. 182 Mio. Euro
 - Kapitalerhöhung um 674 Mio. €, zu 100% gezeichnet
 - Striktes Working-Capital-Management, Investitionsdisziplin
- Konsequente Ausrichtung des Infineon-Portfolios an den Zielmärkten
 - Weltweit führend in den Segmenten ATV, IMM und CCS
 - Verkauf von WLC an Golden Gate Capital
 - Verkauf von WLS an Intel
 - Klare Ausrichtung auf drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft:
 - ↪ Energieeffizienz
 - ↪ Mobilität
 - ↪ Sicherheit

Wir konzentrieren uns auf unsere Zielmärkte

Fokusthemen

- Energieeffizienz
- Mobilität
- Sicherheit



Kernkompetenzen

- Analog- und Mixed-Signal-Schaltungen
- Leistungshalbleiter
- Embedded Control
- Fertigungskompetenz

Unsere Zielmärkte

- Automotive
- Industrial Power Control
- Power Management & Multimarket
- Chip Card & Security



Fokussierung auf drei Bereiche mit hervorragenden Zukunftsperspektiven



Energieeffizienz



Mobilität



Sicherheit



Automotive

Industrial Power Control

Power Management & Multimarket

Chip Card & Security

Energieeffizienz



Wichtige Trends

- Dem dramatisch steigenden weltweiten Energiebedarf stehen schwindende Ressourcen fossiler Energieträger gegenüber
- Strenge CO₂-Richtlinien sollen das Erreichen von Klimazielen sichern
- Erneuerbare Energien werden vermehrt als nachhaltige Ressourcen genutzt
- Elektrifizierung des Antriebsstrangs von Kraftfahrzeugen

Unser Beitrag

- Unsere innovativen Halbleiterlösungen spielen eine wichtige Rolle bei der Minimierung von Leistungsverlusten und steigern die Effizienz der gesamten Energieversorgungskette – von der Erzeugung über die Verteilung bis zur Nutzung.
- Unsere Produkte bilden die Grundlage für die intelligente und optimale Nutzung von Energieressourcen in der Industrie, in Privathaushalten und in Fahrzeugen.



Wichtige Trends

- Strenge CO₂-Richtlinien und steigender Ölpreis
- Neue Sicherheitsvorschriften für die Unfallprävention
- Wachsender Markt für preiswerte Fahrzeuge in Schwellenländern
- Urbanisierung, Globalisierung und demografische Veränderungen
- Große Investitionen in öffentlichen Nah- und Fernverkehr

Unser Beitrag

- Unsere führenden Halbleiterlösungen ermöglichen eine nachhaltige Mobilität, indem sie dazu beitragen, Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Anschaffungskosten zu senken.
- Als Innovationsmotor und Anbieter von Schlüsselkomponenten für Elektro- und Hybridfahrzeuge wird Infineon auch weiter den Wandel in Richtung Elektromobilität mitgestalten.
- Innovative Lösungen für Antriebe und elektronische Tickets im öffentlichen Personenverkehr.



Wichtige Trends

- Bedarf an sicheren Systemen in allen Bereichen des Lebens
- Sichere Kommunikation überall – mit Mobiltelefon und mobilem Internet
- Einführung von elektronischen Ausweisen und Produktkennzeichen
- Zahlungssysteme mit kontaktlosen Karten und elektronische Tickets
- Zunehmender Einsatz von Elektronik im Auto erfordert sicheres Datenmanagement

Unser Beitrag

- Maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für alle Systemanforderungen ermöglichen die Implementierung transparenter Sicherheitsfunktionen in Standardsystemen.
- Sicherheitsanwendungen in der Industrie und im Automobilsektor profitieren von unserer globalen Kompetenz im Bereich Smartcards.
- Unsere Produkte verbinden Hardware-Sicherheit und Verschlüsselung und bilden damit die Grundlage für Vertraulichkeit und Sicherheit sowie erweiterte Kommunikationsfunktionen, ohne die persönliche Freiheit einzuschränken.

Wir orientieren uns an unseren Kunden

Kunden



Automotive

- Leistungshalbleiter
- Leistungs-ICs
- Mikrocontroller
- Sensoren
- Elektrifizierung des Antriebsstrangs



Industrial Power Control

- IGBT Module
- IGBT (Chips & Diskrete Leistungshalbleiter)
- Treiber IC's & Boards
- Modul-Systeme



Power Management & Multimarket

- Diskrete Leistungshalbleiter
- Leistungs - ICs
- ASICs
- RF & Schutz-Bausteine
- Mikrocontroller



Chip Card & Security

- Zahlungsverkehr
- Kommunikation
- Öffentl. Personenverkehr, Zugangskontrolle und Objektidentifikation
- Behördliche Ausweise
- Plattformensicherheit
- Unterhaltung

Vertrieb, Fertigung, zentrale Unternehmensfunktionen

Vorstand

■ Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2012

■ Zielmärkte

■ **Divisionen, Produkte und Technologien**

■ Allgemeine Informationen zum Unternehmen

Enge Kundenbeziehungen basieren auf System-KnowHow und Applikationsverständnis



ATV



IPC



PMM



CCS



Distributoren



Infineon – Marktorientierte Geschäftsstruktur



Divisionen

Kernanwendungen

Automotive



Antriebsstrang (Motor- und Getriebesteuerung); Hybrid- und Elektroauto (Antriebssteuerung für Elektromotor, Batterie-Management, Charger); Karosserie- und Komfortelektronik (Lenkung, Dämpfung, Licht, Klimaanlage, Schiebedach, Fensterheber, Scheibenwischer, zentrale Karosseriesteuergeräte, Türelektronik); Sicherheit (ABS, Airbag, ESP, Abstandswarnung).

Industrial Power Control



Erneuerbare Energieerzeugung, Energieübertragung und -wandlung; Steuerung von elektrischen Antrieben für Industrieanwendungen und Haushaltsgeräte.

Power Management & Multimarket



Lichtmanagement und LED-Beleuchtung; Netzteile für Rechner (Server, PC, Notebook, Netbook, Tablet-Computer), Spielekonsolen und Unterhaltungselektronik; Peripheriegeräte für PCs und Spielekonsolen sowie in Anwendungen der Industrie- und Medizintechnik; Hochfrequenz-Bausteine mit Schutzfunktion für Navigations- und Kommunikationsgeräte (z.B. GPS-Empfänger, Smartphone, Digital-TV).

Chip Card & Security



SIM-Karte; Zahlungsverkehr; Near Field Communication (NFC); elektronische Reisepässe, Personalausweise, Gesundheitskarten und Führerscheine; Transport, Ticketing, Zutrittskontrolle; Objektidentifizierung; Plattform-Sicherheitsanwendungen und Systemlösungen; Authentifizierung, z.B. bei Bezahlfernsehen, Spielekonsolen, Zubehör, Ersatzteilen, Industriesteuerungen.

Kunden

Eine neue Ära: Mehrere Faktoren sorgen für eine steigende Nachfrage im Bereich der Leistungshalbleiter

'90 – '10

'10 – '30

Veränderungen



Bildquelle: Tesla

- Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs sorgt für einen höheren Bedarf an Hochleistungshalbleitern in Automobilen und verdoppelt die Chip-Nachfrage.



- Der Wandel in Richtung erneuerbare Energien erfordert deutlich mehr Hochleistungshalbleiter pro MW generiertem Strom.



Bildquelle: Facebook

- Eine effizientere Stromwandlung sorgt für einen niedrigeren CO₂-Ausstoß und verringert die Material- und Elektrizitätskosten.



- Aufgrund des schnell steigenden Lebensstandards in den BRIC-Staaten erhöht sich die Nachfrage nach Leistungshalbleiterprodukten.



Kernkompetenzen/ Wertbeitrag

- **Nachhaltiges Engagement:** über **40 Jahre System- und Anwendungs-Know-how** im Automotive-Bereich
- **Anbieter kompletter Automotive-Systeme**
- **Hybrid- und Elektrofahrzeuge:** branchenweit **führend bei Know-how** und Produktportfolio
- **Weltweite** Entwicklungs-, Fertigungs- und Support-Standorte für Automotive-Halbleiter
- **Automotive Excellence:** umfangreichstes Qualitätsprogramm in der Halbleiterbranche

Produktpalette

- **Sensorik:** Druck-, Temperatur-, Magnetsensoren; Wireless Control-ICs, Radar
- **Mikrocontroller:** 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit
- **Leistungshalbleiter:** MOSFETs, IGBTs, intelligente Leistungs-ICs: Spannungsregler, Brücken, Treiber-ICs, CAN/LIN/FlexRay™-Transceiver, DC/DC-Wandler, Stromversorgungs-ICs, SoC Embedded Power-ICs
- **Hybrid- und Elektrofahrzeuge:** HybridPACK™-Module, Automotive Easy-Module, Gate-Treiber-ICs, MOSFETs, IGBTs

Marktposition

- **Nr. 2** bei Automotive-Halbleitern weltweit
- **Nr. 1** in Europa
- **Nr. 2** in der NAFTA-Region
- **Nr. 4** in der übrigen Welt

Quelle: Strategy Analytics (April 2011)

* FlexRay ist eine Marke der FlexRay Consortium GbR und wird unter Lizenz verwendet

Fokus auf Zukunftstechnologien

Beispiel 1: Umweltfreundliche Autos

Markttrends

- Knapper werdende Energieressourcen
- Urbanisierung
- Strengere Vorgaben zum CO₂-Ausstoß
- Wachsendes Umweltbewusstsein

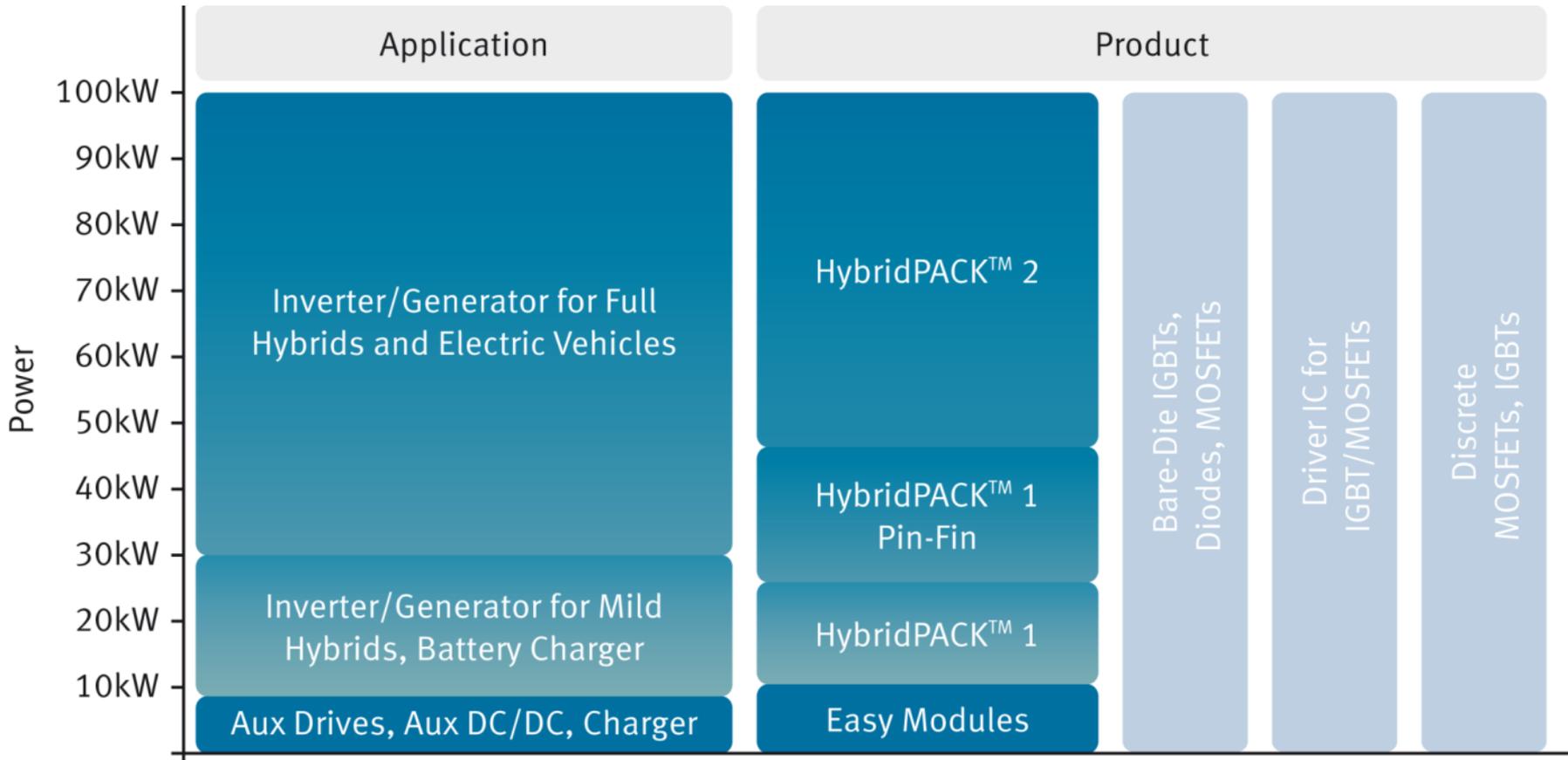
Chancen für Infineon

- Infineon-Bausteine ermöglichen eine erhebliche CO₂-Reduzierung um insgesamt ~23 g/km
- Wir bieten Produkte für den Antriebsstrang von Hybrid- und Elektrofahrzeugen (HybridPACK™)
- Halbleiter machen Elektroautos überhaupt erst möglich (elektrische Antriebe/ Steuerungen, Batteriemangement, integrierte Batterieladefunktionen und Fahrzeugnetzkommunikation)

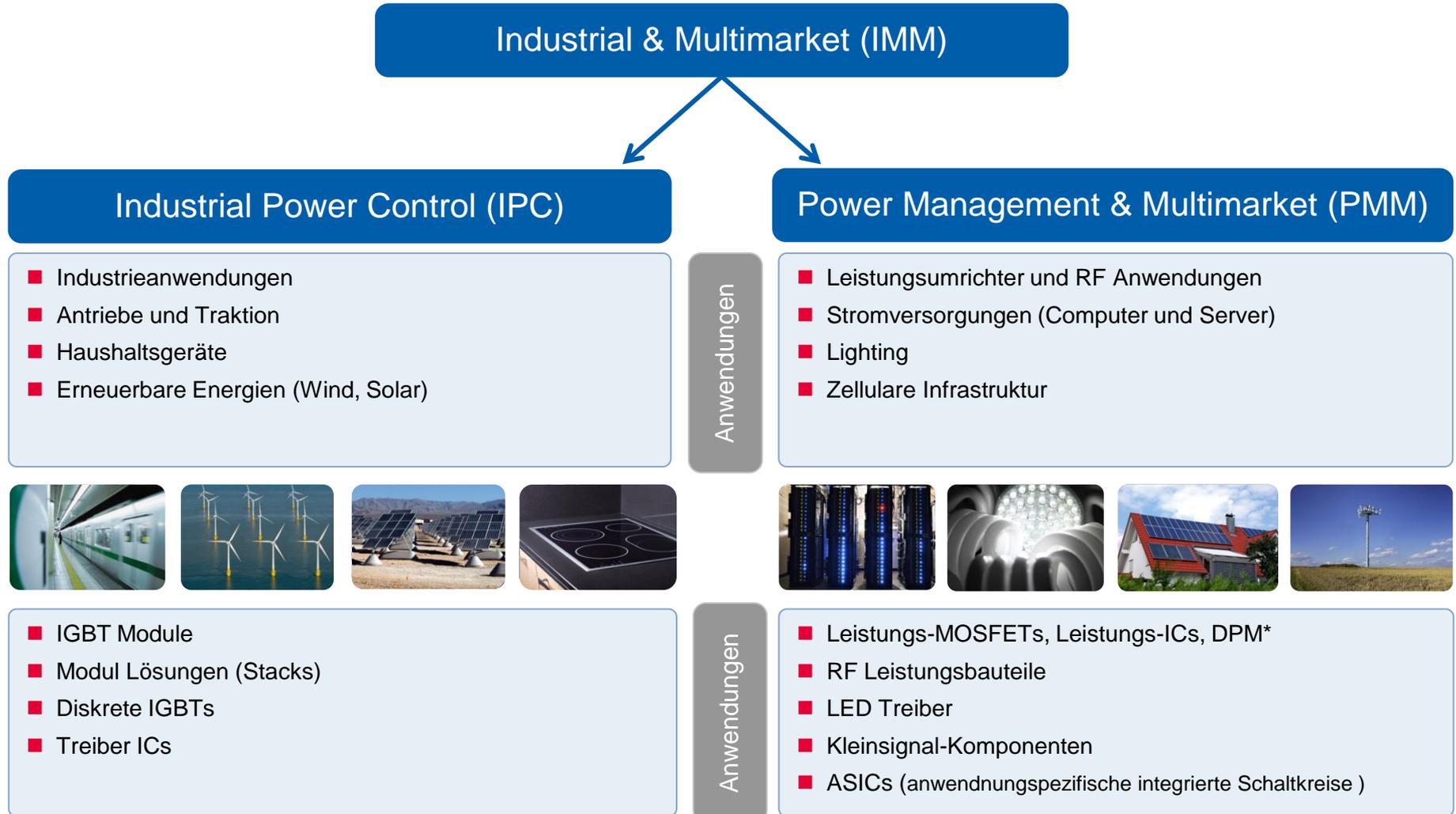
Hinweis: CO₂-Reduzierung bei EU-Durchschnittsautos: 170 g/km



Zielanwendungen für die Elektrifizierung des Antriebsstrangs – Produktportfolio



IMM-Teilung in zwei neue Divisionen zum 1. Januar 2012



*DPM = Digital Power Management /
digitales Leistungsmanagement

Produktpalette

- IGBT Module und Stacks
- IGBT Chips & Diskrete Bauelemente
- Treiber IC's & Treiber-Boards (EiceDRIVER™)



Kernkompetenzen/ Wertbeitrag

- Hochwertige Produkte und Services
- Führendes Technologie- und IP-Portfolio
- System-Know-how und umfassendes Anwendungswissen
- Starke weltweite Präsenz mit Standorten für lokale Vertriebs- und Anwendungsunterstützung
- Dedizierte Kundenbetreuungsteams und Distributoren

Marktposition

- No.1 in High Power Semiconductors mit 11% Marktanteil
- No.1 in Bipolar High Power Semiconductors mit 18% Marktanteil
- No. 2 in Power Modules

Quelle: IMS Research, August 2011

Leistungskomponenten für die Antriebssteuerung bei Zugsystemen

Hochgeschwindigkeitszüge



U-Bahnen



Infineon-Komponenten

- Leistung: 5 bis 10MW pro Zug
- 80 bis 120 IGBT-Module pro Zug
- Halbleiteranteil:
~100.000 EUR pro Zug



- Leistung: 0,5 bis 1MW pro Zug
- 25 bis 50 IGBT-Module pro Zug
- Halbleiteranteil:
~10.000 EUR pro Zug



Produktpalette

- Diskrete Leistungshalbleiter
- Stromversorgungs-ICs
- NF/HF-Dioden und -Transistoren, HF-Leistungsverstärker
- Silizium-MEMS-Mikrofone, TVS-Dioden
- LED-Treiber
- ASIC-Lösungen einschließlich Sicherheits-ASICs für Authentifizierungs- und Markenschutzanwendungen
- Mikrocontroller: 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit

Kernkompetenzen/ Wertbeitrag

- Zuverlässige und innovative Lösungen für heutige und zukünftige Stromversorgung - und HF Anwendungen / Systeme
- Führerschaft bei energieeffizienten Technologien
- System Know How vereint mit breitem Anwendungs- und Systemverständnis
- Expertenteams mit hoher Kundenorientierung von der Entwicklung bis hin zur finalen Anwendung

Marktposition

- Nr.1 bei diskreten Leistungshalbleitern (Marktanteil 8,6%, IMS Research, August 2011)
- Nr. 1 in SiC Leistungselektronik (Marktanteil 51%; Yole, November 2011)
- Nr. 2. bei Silizium-MEMS-Mikrofonen (Marktanteil 17%, IHS isuppli, Januar 2012)
- Nr. 3 bei HF-Leistungshalbleitern (Marktanteil 17%; ABI Research, Oktober 2011)

Leistungskomponenten für energieeffiziente Server und HF Bauteile für Mobilfunk-Infrastruktur



Energieeffiziente Server



Mobilfunk - Infrastruktur



Infineon - Komponenten

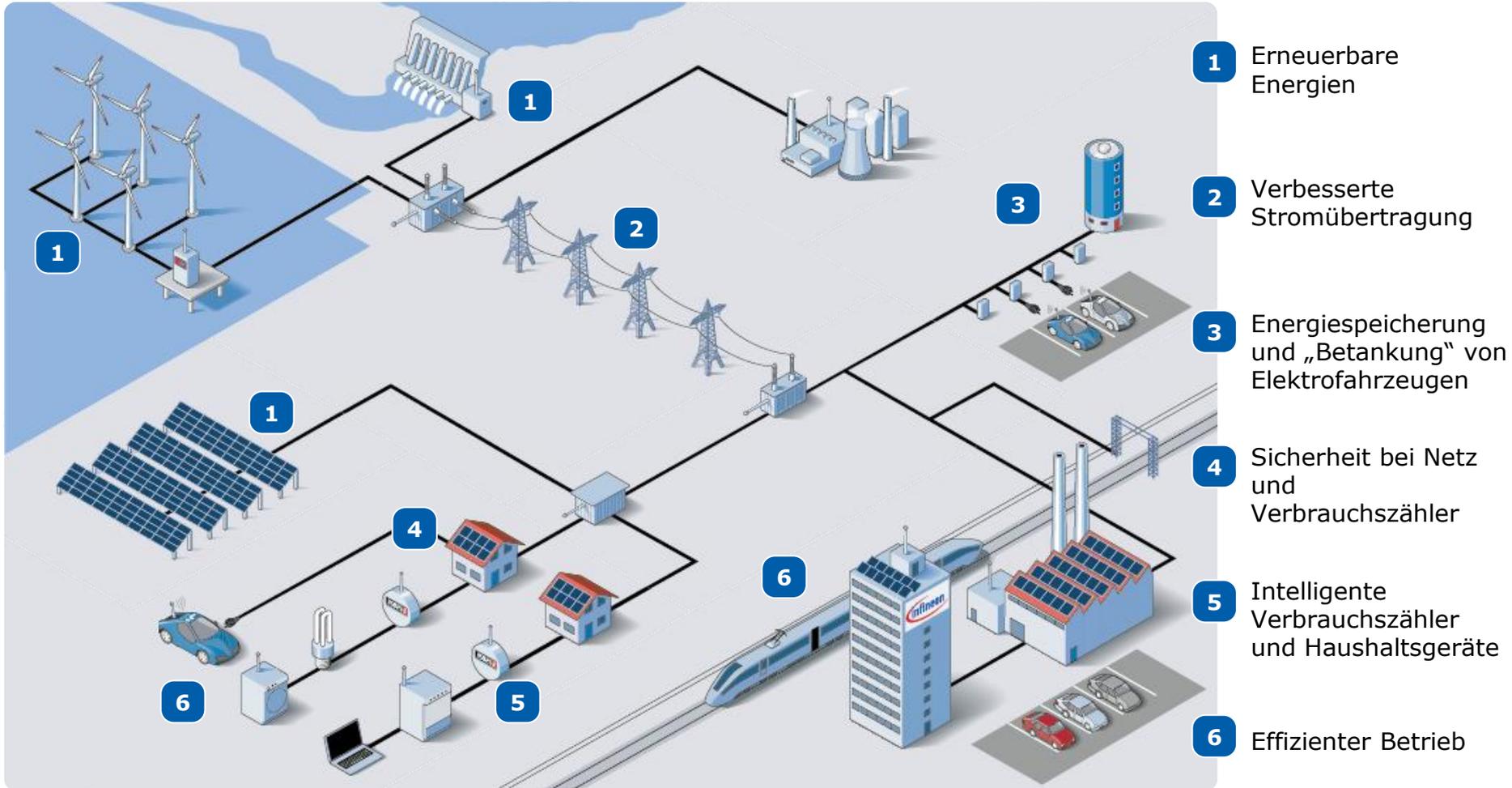
- Effizienzleistungen von 95% und höher
- Technologieführerschaft bei MOSFETs und Siliziumkarbid - Produkten
- Höchste Leistungsdichte für bestes Preis / Leistungs Verhältnis
- Herausragende Systemlösungen mit MOSFETs, ICs und Treiber-Bauelementen



- Abdeckung aller Standard-Frequenzbänder in 2G,3G,4G (450Mhz bis 2.7 GHz)
- Führende Leistungseffizienz für LTE
- Großes Produktportfolio für ein Leistungsspektrum von 4W-700W
- Exzellente thermische Eigenschaften

Fokus auf Zukunftstechnologien

Beispiel 2: Smart Grid





Produktpalette

- Kontaktlose und kontaktbasierte Sicherheitsprodukte für Kommunikation, Zahlungsverkehr, behördliche Ausweise, öffentlichen Personenverkehr, Zugangskontrolle, Objektidentifikation, Unterhaltung und Plattformsicherheit
- Umfassendes Packaging- und Serviceangebot
- Innovative Lösungen von einfachen Sicherheits-RFID- und Speicheranwendungen bis hin zu High-End-Sicherheitscontrollern (z.B. die preisgekrönte SLE 78-Familie)

Kernkompetenzen/ Wertbeitrag

- Tailored Security: maßgeschneiderte Sicherheit mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Contactless Excellence: Schwerpunkt auf Interoperabilität und Dual Interface
- Embedded Control: ausgewogenes Verhältnis von Rechenleistung, Stromverbrauch, Sicherheitsniveau und Kosten

Marktposition

- Seit 14 Jahren Nr. 1 auf dem Chipkarten-IC-Markt mit Marktanteil von 27%¹ nach Umsatz.
- Marktführer bei ICs für Bezahlkarten² mit 42% Marktanteil nach Stück im Jahr 2010.
- Marktführer bei ICs für behördliche Ausweise. Einziger IC Hersteller, der die elektronischen Reisepassprojekte der fünf größten Länder der Welt beliefert. IFX liefert ICs in mehr als 70% der elektronischen Personal-ausweisprojekte Europas.
- Marktführer bei Trusted Platform Modules und Pay-TV.
- Marktführer im Bereich NFC Sicherheitsmicrokontroller mit 51.5% Marktanteil in 2011³.

Quelle: ¹IMS Research, August 2011; ²IMS, Juli 2011; ³IMS, Januar 2012

Konzentration auf Zukunftstechnologien

Beispiel 3: Datenschutz

Markttrends

- Trusted Platform Modules (TPM) in 70% der Business-Notebooks und Desktops; Windows 7 Unterstützung
- Datenschutz: Verschlüsselung von Dateien, Ordnern, Festplatte, E-mails, digitalen Signaturen
- Starke Authentifizierung: Netzwerkzugriff, -Schutz und zusätzliche Authentifizierungsfaktoren

Chancen für Infineon

- Nr. 1 Lieferant für TPMs
- Infineons TPM Sicherheitscontroller sind die ersten mit weltweiter TCG und Common Criteria Zertifizierung und UK Regierungszulassung



Infineons SLE 78-Sicherheitscontroller im neuen elektronischen Personalausweis (nPA)



Der neue elektronische Personalausweis in Deutschland

- Projektstart im **November 2010**
- **Europaweit größtes Personalausweis-Projekt**
- Derzeit ca. 60 Mio. Ausweisinhaber in Deutschland
- **Pro Jahr** werden in Deutschland ca. **6,5 Mio. Ausweiskarten** ausgegeben
- **Infineon** liefert die **Chips für einen Großteil der neuen Ausweise**
- Der neue elektronische Personalausweis (nPA) ist als **eines der fortschrittlichsten Projekte im Bereich Ausweissicherheit** für die beteiligten Technologieanbieter äußerst prestigeträchtig
- Mehr als **70% der elektronischen Personalausweise in Europa** enthalten Sicherheits-Mikrocontroller von **Infineon**



- Der nPA war eines der ersten großen Projekte, in dem die 16-Bit-SLE 78-Controller zum Einsatz kommen
- Die SLE 78-Controller basieren auf der „Integrity Guard“-Technologie



INTEGRITY GUARD

Infineon's SLE 78 Sicherheitscontroller für die neue deutsche elektronische Gesundheitskarte (eGSK)



Deutsche elektronische Gesundheitskarte

- Seit Oktober 2011 zu beantragen und 6 Millionen Karten bis Ende 2011 ausgeliefert.
- Bis 2013 an alle 60 Millionen gesetzlich Versicherten ausgegeben.
- Infineon liefert mindestens 40 Prozent der Sicherheitscontroller.
- Chips sind bereits für zukünftige Anwendungen zur Verbesserung der Effizienz gerüstet (z.B. dem Austausch von medizinischen Informationen).
- Mit Einverständnis des Versicherten können weitere personenbezogene Informationen gespeichert werden.
- Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit Verwaltungsdaten online zu aktualisieren.



- Microcontroller aus der SLE 78 Familie mit "Integrity Guard" Sicherheitstechnologie.
- Infineon ist Marktführer bei Sicherheitscontroller im Bereich der Gesundheitskarte mit 60% Marktanteil.

Die wichtigsten Kunden

Automotive

- Autoliv
- Bosch
- Continental
- Delphi
- Denso
- Hella
- Hyundai
- Kostal
- Lear
- Mitsubishi
- TRW
- Valeo

Industrial Power Control

- ABB
- Alstom
- Bombardier
- General Electric
- Rockwell
- Schneider
- Siemens
- SMA Technology

Power Management & Multimarket

- Dell
- Delta
- Emerson
- Ericsson
- HP
- Huawei
- LG Electronics
- Microsoft
- Nokia
- Power-One
- RIM
- Samsung

Chip Card & Security

- Beijing Watch Data
- Gemalto
- Giesecke & Devrient
- Oberthur
- SAFRAN
- US Government Printing Office

- **Wichtigste Channel-Partner** (Distributoren):
Arrow, Avnet, Beijing Jingchuan, Rutronik, Tomen, Toyotsu, WPG Holding
- **Electronic Manufacturing Services (EMS):**
Celestica, Flextronics, Foxlink, Hon Hai, Jabil, Sanmina-SCI

Das Halbleitertechnologie-Portfolio von Infineon

Infineons Technologieportfolio erfüllt die Anforderungen von Anwendungen für Logik- und Leistungselektronik-Bauelementen

Power/Analog

inkl. Green Robust

Analog Bipolar: DOPL, Ax, BIPEP, B4C
Analog BICMOS: B6CA, B6CA-CT, B7CA, SPT170
 500 - 350nm HV-CMOS-SOI
Smart Power : 1200-130nm BIP/CMOS/DMOS
 SPTx (Automotive, EDP) (BCD)
Smart : CMOS/DMOS, SMARTx,
 (SmartMOS) MSMARTx, SSMARTx Opto-TRIAC
DMOS: Low Voltage Trench
 MOSFET (OptiMOS™)
HV-DMOS: Superjunction MOSFET
 (CoolMOS™)
IGBT: Trench IGBT 600-6500V, rev.
 cond., fast recov. diodes
SiC: Diode, JFET

alle Produkte für Automotive- und Industrieanwendungen geeignet

MEMS/Sensoren

Analog ICs: B6CA, B7CA
 Coreless Transformer
Magnet: BxCAS, C9FLRN_GMR
Opto: OP-DI, OP-TR, OP-C9N, μ-modules
Pressure: BxCSP, TIREPx
Silicon-Microphones

CMOS

Digital CMOS: 800nm – 65nm Technology Nodes (Platform <180nm incl. RF, AMS)
Analog/Mixed Signal: 500nm – 180nm Technology Nodes (CxNA)
eNVM: EEPROM: IMEMR, C9FL, OTP: C5OP (Automotive)
eFlash/EEPROM: 250nm – 65nm CxFL (Chip Card), CxFLA, CxFLN (Automotive)
HV-CMOS: 130nm, C11HV

RF/Bipolar

RF BICMOS: 25GHz – 100GHz: B6HFC, B9COPT, B10C
Bipolar IC: 2GHz...200GHz RF-Bipolar: BxHF
HiPAC: Al/Cu Integrated Passives
 P7Mxx, P7Dxx, P8Mx, P9Mxx
Bipolar/Discrete Bausteine/MMIC:
RF-Transistoren NF-TR; BxHF(D/M),
Leistungsverst.: LDMOS, LDxM, LDxIC, LD9AB
Dioden: NF-DI, Tuner: DxT, Schottky: DxS
SiGe: B7HFM, B7HF_SLC, B7HF200
RF Switches: C7NP, C11NP
SiGe: B7HFD/M, B7HF_SD
RFMOS: HFM
PIN: DxP

Das Gehäusetechnologie-Portfolio von Infineon

IC

Power

Wafer Level Packages, Bare Die

Laminate based Packages

Leadframe based Packages

Chip Card

Discretes

Sensors

High Power

Power

Surface Mount Technology (SMD)

SMD

- OCCN ¹⁾
- BGA
- LBGA
- xFBGA, xFSGA

Wafer Level

w/o redistribution

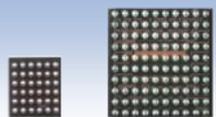
- WLP (fan-in)

w/redistribution

- WLB (fan-in)
- eWLB (fan-out)

Bare Die

- Wirebond
- Flip chip



Flip chip

- FCxBGA
- xF2BGA, xF2SGA



Through Hole

- DIP ²⁾

SMD

- PLCC ²⁾
- TSSOP
- TQFP
- LQFP
- MQFP

Leadless

- VQFN
- WQFN
- O-LQFN ¹⁾
- XSON
- USON



Mold on LF

- P-MCCx

Mold

- P-Mx.x

Chip on Flex

- FTM

UV Globe top

- T-Mx.x

PRELAM

- PPxx

Flip Chip

- S-MFCx.x

Wafer

- Bumped
- Diced



SMD leaded

- SOT
- SOD
- TSOP
- TSSOP
- Flat lead
- TSFP
- SC

Leadless

- TSLP
- TSSLP
- TSNP

Wafer level

- WLP



Through Hole

- PSSO

SMD

- Leaded
- DSOSP

Open cavity

- DSOF



Power Modules

- Easy
- 62mm
- Econo
- Econo-PACK™+
- Prime-PACK™
- IHM
- IHV
- Hybrid-PACK™



Through Hole

- TO, DIP
- SMD
- TO
- DSO
- SSOP

Leadless

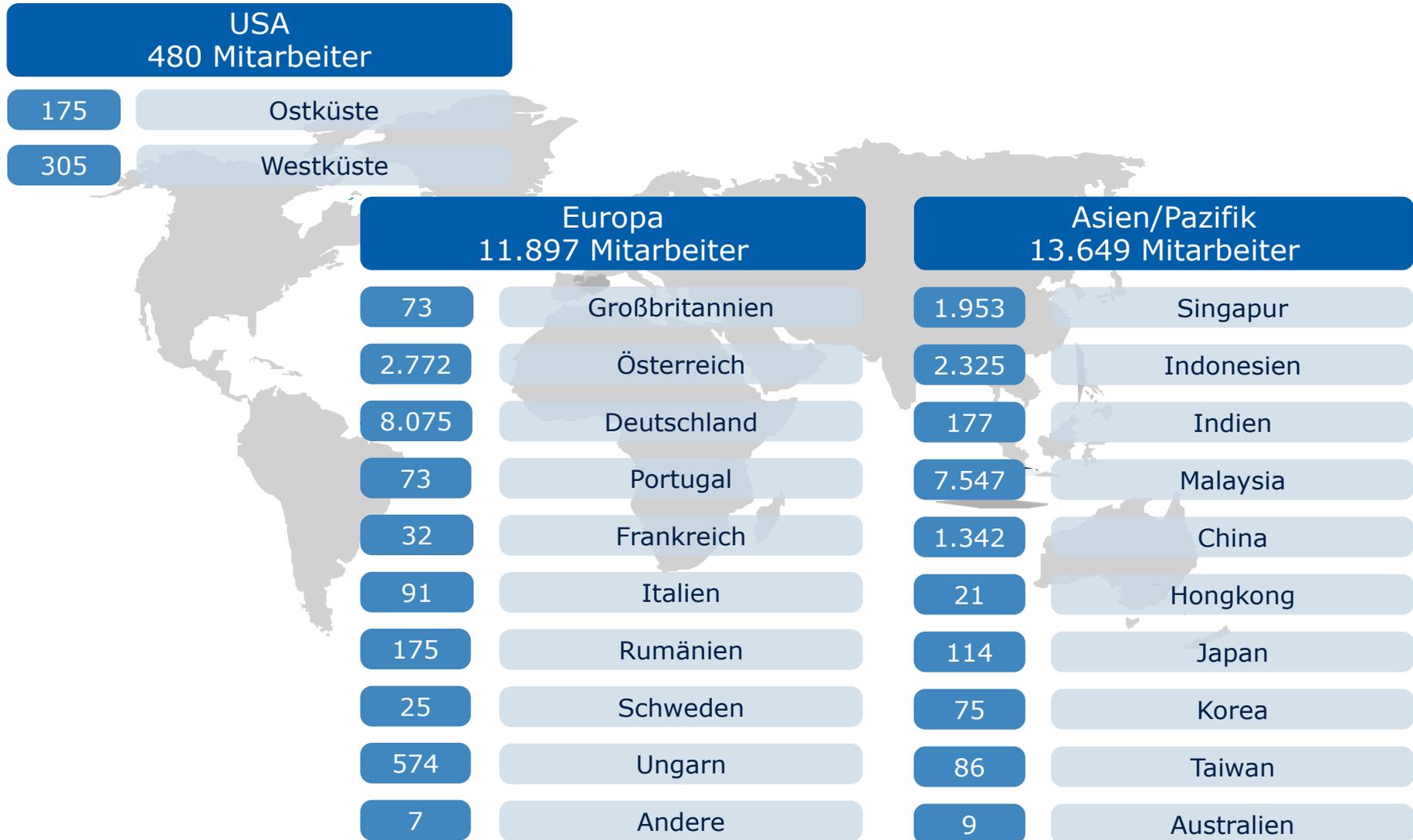
- TDSON
- TSDSON
- CanPAK™
- SON
- IQFN



1) Nur für Spezialanwendungen 2) Auslauf

- Markt- und Geschäftsentwicklung im ersten Quartal GJ 2012
- Zielmärkte
- Divisionen, Produkte und Technologien
- Allgemeine Informationen zum Unternehmen

Infineon: 26.026 Mitarbeiter weltweit



Infineon – F&E-Standorte in Europa



Infineon – Weltweite F&E-Standorte (ohne Europa)



Infineon – Weltweite Fertigungsstätten Frontend- und Backend-Fertigung



● Front-End ● Back-End

Erweiterung der 200mm-Kapazitäten in Kulim; 300mm-Thin-Wafer-Technologie in Dresden

Kulim 2



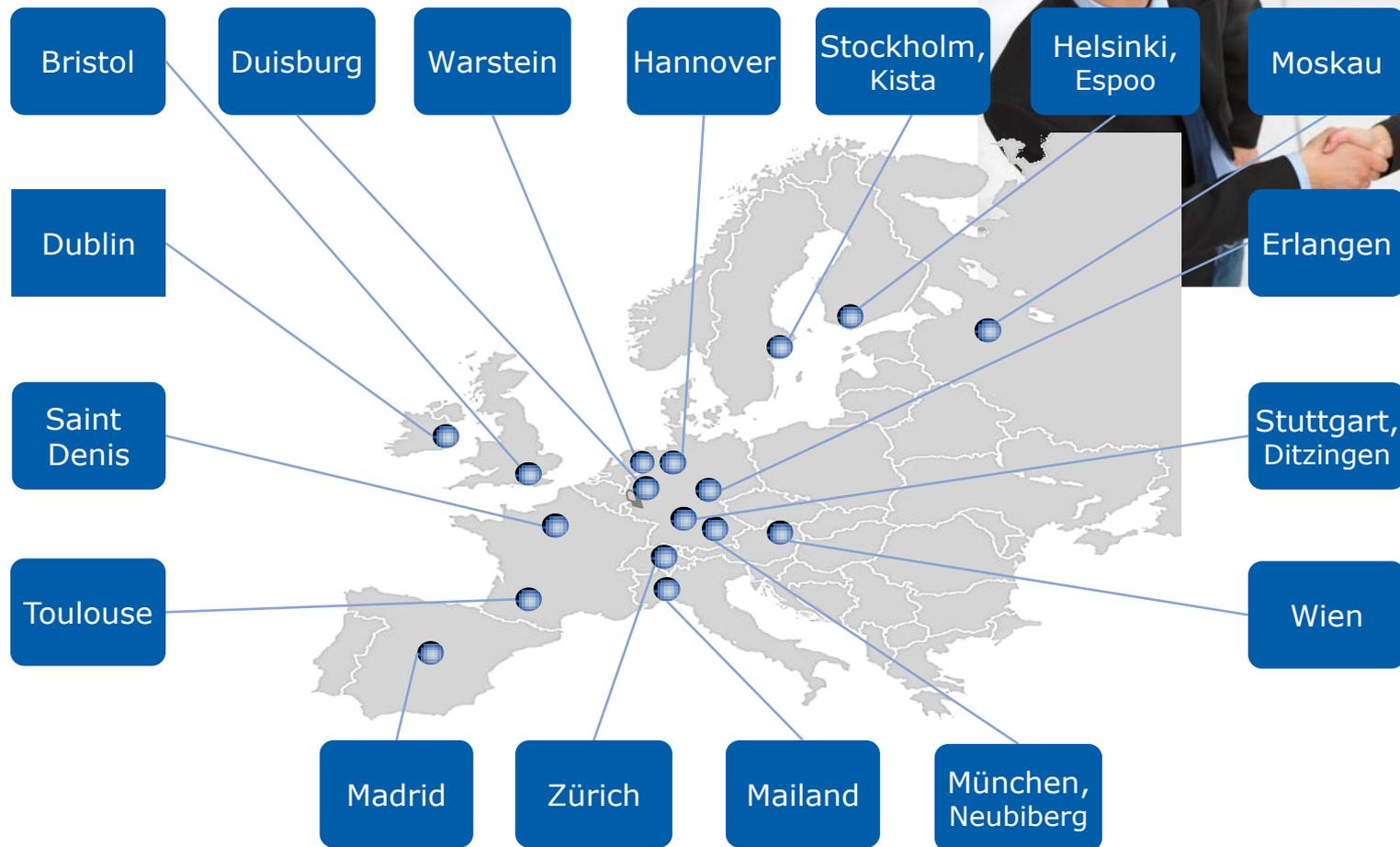
Um das Wachstumspotential voll auszuschöpfen, wird Infineon seine kosteneffiziente 200mm-Fertigung in Kulim (Malaysia) erweitern.

Dresden 300-mm-Technologie



Infineon wird außerdem die Anlage in Dresden für die 300mm-Thin-Wafer-Fertigung von Leistungshalbleitern nutzen, um seine Position als Technologieführer in diesem Bereich weiter auszubauen.

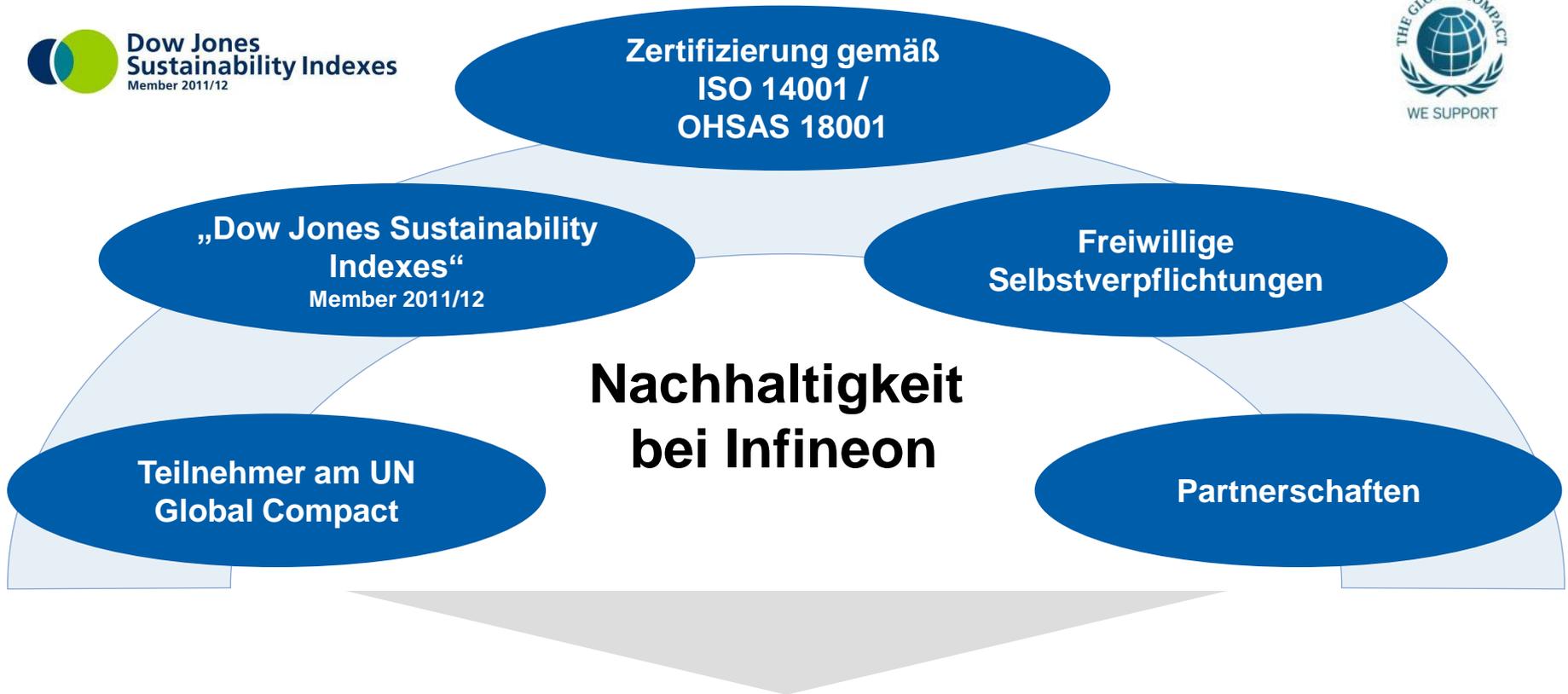
Infineon-Vertriebsbüros in Europa



Infineon-Vertriebsbüros weltweit (ohne Europa)



Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt



Infineon unter den besten 15 % der nachhaltigsten Unternehmen weltweit^{*)}

veröffentlicht im „Sustainability Yearbook 2011“; darin sind die nachhaltigsten Unternehmen weltweit aufgelistet

Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt

IMPRES^{*)}: Synergie aus Verantwortung für Mensch und Umwelt sowie wirtschaftlichem Erfolg

Matrixzertifizierung gemäß EN ISO 14001 und OHSAS 18001



Effizientes Ressourcenmanagement im Umweltschutz

Hohe Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzstandards

Umweltinnovationen

Festgelegte Anforderungen entlang der Lieferkette

Nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln bedeutet für Infineon weit mehr als nur die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben

*) Infineon Integrated Management Program for Environment, Safety & Health

Nachhaltigkeit für Mensch und Umwelt

Unsere Produktion...



■ ... ist Benchmark in der Verhütung von Unfällen

■ ... **spart Energie** analog dem jährlichen Verbrauch **einer Stadt mit 1,7 Millionen Einwohner**

■ ... **schaffte die freiwillige Verpflichtung zur Reduktion der Kyoto Gase (PFC) drei Jahre vor dem Zieltermin der Industrie**

■ ... **verbraucht etwa 58% weniger Wasser pro cm² produziertem Wafer als der globale Durchschnitt**

■ ... **verursacht etwa 49% weniger Abfall pro cm² produziertem Wafer als der globale Durchschnitt**

■ ... **sparte 2002-2010 kumuliert Energie adäquat zu 772.000 Tonnen CO₂ oder etwa 210.000 Tonnen Steinkohle ein.**

IFX trägt maßgeblich zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei

Umweltnutzen

CO₂-Einsparung durch
unsere Produkte⁽¹⁾

4.655.000 Tonnen CO₂

Umweltbelastung

Unsere CO₂-Belastung⁽²⁾
1.000.000 Tonnen CO₂



Infineon trägt zu einer Reduktion von mehr als

3,6 Mio. Tonnen CO₂ Emissionen pro Jahr bei!

1) Berücksichtigt lediglich Automobilprodukte, Ballaststeuerung, PC Energieversorgung, IFX Steuerung;
der eigentliche Betrag ist höher

2) Beinhaltet Produktion, Transport, Reise, Material, Chemie, Emission, Wasser, die Wasserverschwendungswerte
beruhen auf interne Beträge genauso wie die offiziellen Daten

Ganzheitliches Business Continuity Management





ENERGY EFFICIENCY MOBILITY SECURITY

Innovative semiconductor solutions for energy efficiency, mobility and security.

